

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00981)

海外監管公告

本公告乃中芯國際集成電路製造有限公司 (Semiconductor Manufacturing International Corporation, 「本公司」) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《關於2024年度日常關聯交易額度預計的公告》《關於2024年度對外擔保額度預計的公告》《2023年度募集資金存放與實際使用情況鑒證報告》《2024年度日常關聯交易額度預計的核查意見》《2023年度募集資金存放與使用情況的核查意見》《2023年度募集資金存放與實際使用情況鑒證報告》《2023年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項說明》，僅供參閱。

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
公司秘書 / 董事會秘書
郭光莉

中國上海， 2024年3月28日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

劉訓峰

非執行董事

魯國慶

陳山枝

楊魯閩

獨立非執行董事

劉遵義

范仁達

劉明

吳漢明

* 僅供識別

A股代码：688981

A股简称：中芯国际

公告编号：2024-007

港股代码：00981

港股简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司

关于2024年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”或“公司”）2024年3月28日董事会书面决议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，全体董事一致同意该议案。

根据公司《经修订及重述组织章程大纲及章程细则》及《关联（连）交易管理制度》等相关规定，本次关联交易事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况，公司 2024 年度日常关联交易预计额度约为 649,168 千元，具体情况如下：

单位：人民币千元

关联人	关联交易类别	2024 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2024 年 2 月 29 日与关联人累计已发生的交易金额	2023 年度实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司	采购货物	460	-	426	32	0.0	/
	接受劳务	300	0.1	-	929	0.2	/
	向关联方出租资产	2,291	1.3	532	5,008	2.9	/
	向关联方买入机器设备	33,950	0.2	8,854	130,165	0.6	/
	小计	37,001	/	9,812	136,134	/	/
中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司	接受劳务	2,406	7.9	438	5,265	9.7	/
	向关联方出租资产	3,727	3.7	157	6,040	3.5	/
	小计	6,133	/	595	11,305	/	/
凸版迪色丝电子传感器（上海）有限公司（原“凸版中芯彩晶电子（上海）有限公司”）	采购货物	52,329	0.4	13,538	30,240	0.2	/
	向关联方出租资产	33,705	19.4	6,757	33,519	19.3	/
	小计	86,034	/	20,295	63,759	/	/
灿芯半导体（上海）股份有限公司	销售货物	520,000	1.3	91,738	433,673	1.1	/
总计		649,168	/	122,440	644,871	/	/

注 1：上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2023 年度经审计同类业务的发生额。

注 2：上述预计额度允许在同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂。

注 3：上表中需说明金额差异较大原因的标准为差异金额占公司最近一期经审计总资产 0.1%以上。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币千元

关联人	关联交易类别	2023年度预计金额	2023年度实际发生金额
盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司	采购货物	220	32
	接受劳务	1,500	929
	向关联方出租资产	2,650	5,008
	向关联方买入机器设备	165,000	130,165
	向关联方卖出机器设备	2,100	-
	小计	171,470	136,134
中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司	接受劳务	4,375	5,265
	向关联方出租资产	5,701	6,040
	小计	10,076	11,305
凸版迪色丝电子传感器（上海）有限公司（原“凸版中芯彩晶电子（上海）有限公司”）	采购货物	32,148	30,240
	向关联方出租资产	29,556	33,519
	小计	61,704	63,759
灿芯半导体（上海）股份有限公司	销售货物	678,000	433,673
总计		921,250	644,871

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司

公司名称	盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司
公司性质	有限责任公司(中外合资)
法定代表人	项习飞
注册资本	12,222.0052 万美元
成立日期	2018年3月22日
住所/主要办公地点	浙江省宁波市鄞州区云龙镇石桥村
主营业务	半导体设备的研发、生产、销售和相关技术服务；半导体设备及配件的翻新改造安装维护销售等
主要股东或实际控制人	天津吉盛管理咨询合伙企业（有限合伙）：持股比例 10.64% 中芯国际控股有限公司：持股比例 8.32% 宁波芯空间盛芯创业投资合伙企业（有限合伙）：持股比例 7.47% TRIPLECORES KOREA CO.,LTD.: 持股比例 6.93% 上海新阳半导体材料股份有限公司：持股比例 5.91%

2、中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司

公司名称	中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司
公司性质	其他有限责任公司
法定代表人	高永岗
注册资本	10,000 万人民币
成立日期	2014 年 2 月 27 日
住所/主要办公地点	上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 337 室
主营业务	股权投资管理，投资管理
主要股东或实际控制人	上海芯齐投资中心（有限合伙）：持股比例 35.00% 中芯国际集成电路制造（上海）有限公司：持股比例 19.51% 宁波道至丰投资管理有限公司：持股比例 17.50% 宁波月湖香庄文化发展有限公司：持股比例 17.50% 芯空间控股有限公司：持股比例 10.49%

3、凸版迪色丝电子传感器（上海）有限公司

公司名称	凸版迪色丝电子传感器（上海）有限公司
公司性质	有限责任公司(外商合资)
法定代表人	植木哲朗
注册资本	6,400 万美元
成立日期	2004 年 11 月 24 日
住所/主要办公地点	中国（上海）自由贸易试验区张江路 18 号 2 号楼 1 楼
主营业务	成像传感器的设计，晶圆彩膜及微型镜头的设计、生产、加工
主要股东或实际控制人	凸版印刷株式会社（日本）：持股比例 70% 中芯国际集成电路制造有限公司：持股比例 30%

4、灿芯半导体（上海）股份有限公司

公司名称	灿芯半导体（上海）股份有限公司
公司性质	股份有限公司（港澳台投资、未上市）
法定代表人	ZHIQING JOHN ZHUANG（庄志青）
注册资本	9,000 万人民币
成立日期	2008 年 7 月 17 日
住所/主要办公地点	中国（上海）自由贸易试验区张东路 1158 号礼德国际 2 号楼 6 楼
主营业务	集成电路的设计、研发，软件的研发、制作，销售自产产品，并提供相关技术咨询和技术服务，上述同类产品的批发佣金代理（拍卖除外）。
主要股东或实际控制人	中芯国际控股有限公司：持股比例 18.98% NORWEST VENTURE PARTNERS X,LP：持股比例 13.47%

	嘉兴君柳投资合伙企业（有限合伙）：持股比例 5.93% BRITE EAGLE HOLDINGS,LLC：持股比例 5.43%
--	--

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联人	与上市公司关联关系
1	盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司	过去 12 个月，公司前任董事长高永岗博士在该公司担任董事长，自 2024 年 6 月起，该公司不再是公司关联方。
2	中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司	过去 12 个月，公司前任董事长高永岗博士在该公司担任董事长，自 2024 年 8 月起，该公司不再是公司关联方。
3	凸版迪色丝电子传感器（上海）有限公司	公司联合首席执行官赵海军担任该公司副董事长
4	灿芯半导体（上海）股份有限公司	公司联合首席执行官赵海军担任该公司董事长

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，双方交易能正常结算，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司日常关联交易主要涉及原材料及设备采购、晶圆代工及资产租赁等内容，交易价格均参照市场独立第三方同类交易的价格协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

1、公司全资子公司中芯国际控股有限公司与盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司签署了 2 份《租赁合同》，向盛吉盛出租场地用作办公用房，协议期限分别为 2021 年 7 月 15 日至 2025 年 1 月 14 日、2023 年 4 月 15 日至 2025 年 1 月 14 日。中芯国际集成电路制造（北京）有限公司与盛吉盛签署了《租赁合同》、《办公室/工位租赁协议》，出租办公室给盛吉盛使用，协议期限分别为 2021 年 8 月 1 日至 2025 年 7 月 30 日、2022 年 10 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。

2、公司全资子公司中芯国际控股有限公司与中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司签署了《租赁合同》及《办公室租赁合同》，向中芯聚源出租场地用作办公用房，协议期限分别为2023年11月1日至2025年8月31日、2022年3月1日至2025年8月31日。中芯晶圆股权投资（上海）有限公司与中芯聚源签署了《委托管理协议》及补充协议，委托中芯聚源管理其资产，协议期限为2019年9月5日至2029年2月26日。

3、公司全资子公司中芯国际集成电路制造（上海）有限公司、中芯国际集成电路制造（北京）有限公司、中芯国际集成电路制造（天津）有限公司，以及控股子公司中芯南方集成电路制造有限公司、中芯国际集成电路制造（深圳）有限公司分别与灿芯半导体（上海）股份有限公司签署了《芯片代工协议》，协议期限分别为2022年5月4日至2027年5月3日、2021年8月17日至2026年8月16日、2022年1月1日至2026年12月31日、2020年4月1日至2025年3月31日、2021年6月2日至2026年6月1日。

4、公司全资子公司中芯国际集成电路制造（上海）有限公司与凸版迪色丝电子传感器（上海）有限公司签署了《租赁合同》的补充协议，向凸版出租厂房的期限延至2026年7月31日。

除已签署协议外，公司与上述关联方将在董事会书面决议通过2024年度日常关联交易额度预计事项后，根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方之间的交易是基于日常业务过程中按一般商业条款进行，关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，联合保荐机构海通证券、中金公司认为：

本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《经修订及重述组织章程大纲及细则》、《关联（连）交易管理制度》等相关规定；本次关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展，关联交易基于日常业务过程中按一般商业条款进行，关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。联合保荐机构对公司2024年度日常关联交易额度预计事项无异议。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会

2024年3月29日

A股代码：688981

A股简称：中芯国际

公告编号：2024-008

港股代码：00981

港股简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司

关于2024年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- **被担保人：**中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司。
- **本次担保金额及实际担保余额：**公司预计2024年度为子公司提供新增担保额度合计不超过人民币（或等值外币）7,000,000.00万元。截至2024年2月29日，公司已实际为合并报表范围内子公司提供的担保余额为人民币（或等值外币）2,039,936.79万元。
- **本次担保是否有反担保：**否
- **本事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会进行审议。**

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）根据其业务发展规划，并结合子公司的实际需求，预计2024年度为合并报表范围内的子公司提供新增担保额度合计不超过人民币（或等值外币）7,000,000万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	被担保人	担保额度	公司持股比例
1	中芯集电投资（上海）有限公司	500,000	100%
2	中芯国际控股有限公司	6,000,000	100%
3	中芯国际集成电路制造（上海）有限公司	100,000	100%
4	中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	100,000	100%
5	中芯国际集成电路制造（天津）有限公司	100,000	100%
6	中芯西青集成电路制造有限公司	100,000	100%
7	中芯国际集成电路新技术研发（上海）有限公司	50,000	100%
8	芯电半导体（上海）有限公司	50,000	100%
	合计	7,000,000	

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，在新增担保额度内调剂使用。

（二）本次担保事项履行的审议程序

公司2024年3月28日董事会书面决议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。根据公司《经修订及重述组织章程大纲及章程细则》及《对外担保管理制度》的相关要求，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。上述担保预计额度有效期为董事会审议通过之日起12个月。

二、被担保人基本情况

（一）中芯集电投资（上海）有限公司

- 1、成立日期：2003年9月30日
- 2、注册资本：46,580万美元
- 3、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区张江路18号

4、法定代表人：刘训峰

5、经营范围：在国家允许外商投资的领域依法进行投资；集成电路相关电子产品的研发、生产（由分支机构经营）；受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：（1）协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；（2）在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；（3）为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；（4）协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；承接其母公司和关联公司的服务外包业务；集成电路产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）中芯国际控股有限公司

1、成立日期：2015年7月28日

2、注册资本：5,000万美元

3、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区丹桂路1059号1幢

4、法定代表人：刘训峰

5、经营范围：在国家允许外商投资的领域依法进行投资；受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所提供企业提供下列服务：（1）协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；（2）在外汇管理系统部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；（3）为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；（4）协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的

研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；承接其母公司和关联公司的服务外包业务；集成电路产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务；自有物业出租。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（三）中芯国际集成电路制造（上海）有限公司

1、成立日期：2000年12月21日

2、注册资本：244,000万美元

3、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区张江路18号

4、法定代表人：刘训峰

5、经营范围：半导体（硅片及各类化合物半导体）集成电路芯片制造、针测及测试，与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、光掩膜制造、测试封装，销售自产产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（四）中芯国际集成电路制造（北京）有限公司

1、成立日期：2002年7月25日

2、注册资本：100,000万美元

3、注册地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道18号

4、法定代表人：刘训峰

5、经营范围：半导体（硅片及各类化合物半导体）集成电路芯片的制造、针测及测试、光掩膜制造；与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、测试封装；销售自产产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（五）中芯国际集成电路制造（天津）有限公司

1、成立日期：2003年11月3日

2、注册资本：129,000万美元

3、注册地点：天津市西青经济开发区兴华道19号

4、法定代表人：刘训峰

5、经营范围：半导体（硅片及各类化合物半导体）集成电路芯片制造、针测及测试，与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、光掩膜制造、测试封装，销售自产产品、及以上相关服务；自有房屋租赁。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）中芯西青集成电路制造有限公司

1、成立日期：2022年8月24日

2、注册资本：500,000万美元

3、注册地点：天津市西青经济技术开发区赛达十一纬路18号

4、法定代表人：刘训峰

5、经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子专用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（不含投资人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；计量技术服务；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。

（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（七）中芯国际集成电路新技术研发（上海）有限公司

1、成立日期：2014年10月28日

2、注册资本：40,000万美元

3、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区张江路18号3号楼6楼

4、法定代表人：王永

5、经营范围：集成电路的制造、技术开发、技术咨询、技术服务、自有技术转让、销售自产产品，从事上述相关产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖

除外），并提供相关配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（八）芯电半导体（上海）有限公司

1、成立日期：2009年3月3日

2、注册资本：1,200万美元

3、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区张江路18号2号楼1楼-1

4、法定代表人：刘训峰

5、经营范围：半导体（硅片及各类化合物半导体）集成电路芯片制造、针测及测试，与集成电路有关的开发、设计服务、光掩膜制造、测试封装、销售自产产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项有助于提高公司融资与结算业务的运作效率，满足公司整体生产经营的实际需要，且被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的子公司，担保风险总体可控。

五、董事会意见

董事会认为：上述担保事项有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需要。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2024年2月29日，公司及其控股子公司对外担保余额为2,039,936.79万元（已经汇率折算），其中公司为控股子公司提供的担保余额为40,808.04万元（已经汇率折算）。上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为

14.32%、0.29%，占公司最近一期经审计总资产的比例为6.03%、0.12%。

截止本公告披露日，公司及子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况。公司无逾期担保的情况，涉及诉讼的担保金额为0元。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会

2024年3月29日

海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司

关于中芯国际集成电路制造有限公司

2024年度日常关联交易额度预计的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“联合保荐机构”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“联合保荐机构”）作为中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司2024年度日常关联交易额度预计事项进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司2024年3月28日董事会书面决议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，出席会议的全体董事一致同意该议案。

根据公司《经修订及重述组织章程大纲及章程细则》及《关联（连）交易管理制度》等相关规定，本次关联交易事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况，公司2024年度日常关联交易预计额度约为64,916.8万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联人	关联交易类别	2024 年度 预计金额	占同类业 务比例 (%)	本年年初 至 2024 年 2 月 29 日 与关联人 累计已发 生的交易 金额	2023 年度 实际发生 金额	占同类业 务比例 (%)	本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因
盛吉盛（宁波）半 导体科技有限公司	采购货物	46.0	-	42.6	3.2	0.0	/
	接受劳务	30.0	0.0	-	92.9	0.0	/
	向关联方出租资产	229.1	0.1	53.2	500.8	0.3	/
	向关联方买入机器 设备	3,395.0	0.0	885.4	13,016.5	0.1	/
	小计	3,700.1	/	981.2	13,613.4	/	/
中芯聚源股权投资 管理（上海）有限 公司	接受劳务	240.6	0.8	43.8	526.5	1.0	/
	向关联方出租资产	372.7	0.4	15.7	604.0	0.4	/
	小计	613.3	/	59.5	1,130.5	/	/
凸版迪色丝电子传 感器（上海）有限 公司（原“凸版中 芯彩晶电子（上 海）有限公司”）	采购货物	5,232.9	0.0	1,353.8	3,024.0	0.0	/
	向关联方出租资产	3,370.5	1.9	675.7	3,351.9	1.9	/
	小计	8,603.4	/	2,029.5	6,375.9	/	/
灿芯半导体（上 海）股份有限公司	销售货物	52,000.0	0.1	9,173.8	43,367.3	0.1	/
总计		64,916.8	/	12,244.0	64,487.1	/	/

注 1：上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2023 年度经审计同类业务的发生额。

注 2：上述预计额度允许在同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂。

注 3：上表中需说明金额差异较大原因的标准为差异金额占公司最近一期经审计总资产 0.1% 以上。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联人	关联交易类别	2023 年度预计金额	2023 年度实际发生金额
盛吉盛（宁波）半导 体科技有限公司	采购货物	22.0	3.2
	接受劳务	150.0	92.9
	向关联方出租资产	265.0	500.8
	向关联方买入机器设备	16,500.0	13,016.5

关联人	关联交易类别	2023 年度预计金额	2023 年度实际发生金额
	向关联方卖出机器设备	210.0	-
	小计	17,147.0	13,613.4
中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司	接受劳务	437.5	526.5
	向关联方出租资产	570.1	604.0
	小计	1,007.6	1,130.5
凸版迪色丝电子传感器（上海）有限公司 （原“凸版中芯彩晶电子（上海）有限公司”）	采购货物	3,214.8	3,024.0
	向关联方出租资产	2,955.6	3,351.9
	小计	6,170.4	6,375.9
灿芯半导体（上海）股份有限公司	销售货物	67,800.0	43,367.3
总计		92,125.0	64,487.1

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司

公司名称	盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司
公司性质	有限责任公司(中外合资)
法定代表人	项习飞
注册资本	12,222.0052 万美元
成立日期	2018 年 3 月 22 日
住所/主要办公地点	浙江省宁波市鄞州区云龙镇石桥村
主营业务	半导体设备的研发、生产、销售和相关技术服务；半导体设备及配件的翻新改造安装维护销售等
主要股东或实际控制人	天津吉盛管理咨询合伙企业（有限合伙）：持股比例 10.64% 中芯国际控股有限公司：持股比例 8.32% 宁波芯空间盛芯创业投资合伙企业（有限合伙）：持股比例 7.47% TRIPLECORES KOREA CO.,LTD.：持股比例 6.93% 上海新阳半导体材料股份有限公司：持股比例 5.91%

2、中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司

公司名称	中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司
公司性质	其他有限责任公司
法定代表人	高永岗
注册资本	10,000 万人民币
成立日期	2014 年 2 月 27 日

住所/主要办公地点	上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 337 室
主营业务	股权投资管理，投资管理
主要股东或实际控制人	上海芯齐投资中心（有限合伙）：持股比例 35.00% 中芯国际集成电路制造（上海）有限公司：持股比例 19.51% 宁波道至丰投资管理有限公司：持股比例 17.50% 宁波月湖香庄文化发展有限公司：持股比例 17.50% 芯空间控股有限公司：持股比例 10.49%

3、凸版迪色丝电子传感器（上海）有限公司

公司名称	凸版迪色丝电子传感器（上海）有限公司
公司性质	有限责任公司(外商合资)
法定代表人	植木哲朗
注册资本	6,400 万美元
成立日期	2004 年 11 月 24 日
住所/主要办公地点	中国（上海）自由贸易试验区张江路 18 号 2 号楼 1 楼
主营业务	成像传感器的设计，晶圆彩膜及微型镜头的设计、生产、加工
主要股东或实际控制人	凸版印刷株式会社（日本）：持股比例 70% 中芯国际集成电路制造有限公司：持股比例 30%

4、灿芯半导体（上海）股份有限公司

公司名称	灿芯半导体（上海）股份有限公司
公司性质	股份有限公司（港澳台投资、未上市）
法定代表人	ZHIQING JOHN ZHUANG（庄志青）
注册资本	9,000 万人民币
成立日期	2008 年 7 月 17 日
住所/主要办公地点	中国（上海）自由贸易试验区张东路 1158 号礼德国际 2 号楼 6 楼
主营业务	集成电路的设计、研发，软件的研发、制作，销售自产产品，并提供相关技术咨询和技术服务，上述同类产品的批发佣金代理（拍卖除外）。
主要股东或实际控制人	中芯国际控股有限公司：持股比例 18.98% NORWEST VENTURE PARTNERS X,L.P：持股比例 13.47% 嘉兴君柳投资合伙企业（有限合伙）：持股比例 5.93% BRITE EAGLE HOLDINGS,LLC：持股比例 5.43%

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联人	与上市公司关联关系
1	盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司	过去 12 个月，公司前任董事长高永岗博士在该公司担任董事长，自 2024 年 6 月起，该公司不再是公司关联方。

2	中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司	过去 12 个月，公司前任董事长高永岗博士在该公司担任董事长，自 2024 年 8 月起，该公司不再是公司关联方。
3	凸版迪色丝电子传感器（上海）有限公司	公司联合首席执行官赵海军担任该公司副董事长
4	灿芯半导体（上海）股份有限公司	公司联合首席执行官赵海军担任该公司董事长

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，双方交易能正常结算，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司日常关联交易主要涉及原材料及设备采购、晶圆代工及资产租赁等内容，交易价格均参照市场独立第三方同类交易的价格协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

1、公司全资子公司中芯国际控股有限公司与盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司签署了2份《租赁合同》，向盛吉盛出租场地用作办公用房，协议期限分别为2021年7月15日至2025年1月14日、2023年4月15日至2025年1月14日。中芯国际集成电路制造（北京）有限公司与盛吉盛签署了《租赁合同》、《办公室/工位租赁协议》，出租办公室给盛吉盛使用，协议期限分别为2021年8月1日至2025年7月30日、2022年10月1日至2024年9月30日。

2、公司全资子公司中芯国际控股有限公司与中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司签署了《租赁合同》及《办公室租赁合同》，向中芯聚源出租场地用作办公用房，协议期限分别为2023年11月1日至2025年8月31日、2022年3月1日至2025年8月31日。中芯晶圆股权投资（上海）有限公司与中芯聚源签署了《委托管理协议》及补充协议，委托中芯聚源管理其资产，协议期限为2019年9月5日至2029年2月26日。

3、公司全资子公司中芯国际集成电路制造（上海）有限公司、中芯国际集成电路制造（北京）有限公司、中芯国际集成电路制造（天津）有限公司，以及控股子公司中芯南方集成电路制造有限公司、中芯国际集成电路制造（深圳）有限公司分别与灿芯半导体（上海）股份有限公司签署了《芯片代工协议》，协议期限分别为2022年5月4日至2027年5月3日、2021年8月17日至2026年8月16日、2022年1月1日至2026年12月31日、2020年4月1日至2025年3月31日、2021年6月2日至2026年6月1日。

4、公司全资子公司中芯国际集成电路制造（上海）有限公司与凸版迪色丝电子传感器（上海）有限公司签署了《租赁合同》的补充协议，向凸版出租厂房的期限延至2026年7月31日。

除已签署协议外，公司与上述关联方将在董事会书面决议通过2024年度日常关联交易额度预计事项后，根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方之间的交易是基于日常业务过程中按一般商业条款进行，关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，联合保荐机构海通证券、中金公司认为：

本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《经修订及重述组织章程大纲及细则》、《关联(连)交易管理制度》等相关规定；本次关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展，关联交易基于日常业务过程中按一般商业条款进行，关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。联合保荐机构对公司2024年度日常关联交易额度预计事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为海通证券股份有限公司关于《中芯国际集成电路制造有限公司2024年度日常关联交易额度预计的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

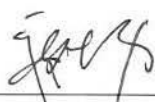

郑瑜


陈城



(本页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《中芯国际集成电路制造有限公司2024年度日常关联交易额度预计的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



魏先勇



李扬



海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于 中芯国际集成电路制造有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“联合保荐机构”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“联合保荐机构”）作为中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对中芯国际2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1278号）的批准，中芯国际首次公开发行人民币普通股（A股）股票 193,846.30万股（含超额配售选择权），发行价格人民币27.46元/股，本次发行最终募集资金总额为人民币5,323,019.40万元，扣除保荐承销费后实际收到募集资金金额为人民币5,253,820.15万元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月14日及8月17日分别出具了普华永道中天验字[2020]第0590号《验资报告》及普华永道中天验字[2020]第0739号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

项目	金额（人民币万元）
实际收到的募集资金金额	5,253,820.15

减：支付发行费用	2,259.43
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	449,445.27
减：募投项目累计支出金额	4,843,167.20
减：募集资金账户销户利息转出	21.20
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	41,072.95
截至2023年12月31日募集资金专户余额	0.00

截至2023年12月31日，公司募集资金已经按照募集资金用途全部投入募投项目使用完毕，并于2023年12月31日前完成全部募集资金专户的销户手续。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户。2020年7月7日及2020年8月21日，公司与联合保荐机构海通证券、中金公司及存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》及《募集资金（针对超额配售）专户存储四方监管协议》。2021年4月7日及2021年4月26日，公司与海通证券、中金公司分别同中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。针对不同的募集资金投资项目，公司与项目公司实施主体、海通证券、中金公司分别同中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中信银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2023年12月31日，公司已完成全部募集资金专户的销户手续，上述募集资金监管协议相应终止。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金专户的余额列示如下：

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额（人民币万元）	备注
招商银行上海分行营业部	NRA110925662010101	活期存款	0.00	已销户
招商银行上海分行营业部	NRA110925662032501	活期存款	0.00	已销户
中国银行上海市浦东开发区支行	444280470222	活期存款	0.00	已销户
中国银行上海市浦东开发区支行	437780471584	活期存款	0.00	已销户
民生银行上海金桥支行	630984295	活期存款	0.00	已销户
中国农业银行上海张江高科技园区支行	03348700040035789	活期存款	0.00	已销户
中信银行广州珠江新城支行	8110901011901196131	活期存款	0.00	已销户
浦发银行上海虹桥支行	98860078801300001507	活期存款	0.00	已销户
FT农行上海金桥支行国际部	FTN09778100048500217	活期存款	0.00	已销户
中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行	FTN000009907	活期存款	0.00	已销户

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年度，公司不存在用闲置募集资金投资现金管理类产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金及超额配售募集资金用于在建项目及新项目（包括收购资产

等)的情况

2020年8月6日,公司董事会审议通过了《关于公司首次公开发行股票超额募集资金用途的议案》,同意公司利用超募资金中的人民币1,000,000.00万元、人民币500,000.00万元、人民币300,000.00万元分别用于12英寸芯片SN1项目、成熟工艺生产线建设项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议通过。

2020年8月6日,公司召开董事会会议,审议通过《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后续相关事项的议案》。根据该议案,董事会授权董事长、联合首席执行官及联席公司秘书中任何一位人士代表公司审议同意超额配售选择权实施情况,并授权董事长、联合首席执行官及联席公司秘书中任何一位人士代表公司签署与此相关的法律文件,以及提交任何必要的文件,并采取所有适用法律、规则及规例要求或据此进行的任何与此相关的行动(包括于香港联交所、上海证券交易所及本公司网站刊发公告)。2020年8月14日,联席公司秘书代表公司审议通过《关于公司首次公开发行股票超额配售选择权实施情况的议案》。根据该议案,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票超额配售选择权于2020年8月14日全额行使,发行总股数扩大至193,846.30万股。全额行使超额配售权所发行股票对应的募集资金总额为人民币694,306.88万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币685,280.89万元,分别用于成熟工艺生产线建设项目人民币479,696.62万元及补充流动资金人民币205,584.27万元。

(七) 节余募集资金使用情况

2023年度,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

根据公司《募集资金管理制度》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,公司在募投项目实施期间,通过银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式,以自有资金支付募集资金投资项目中所涉及的部分设备采购及原材料支出,并定期以募集资金等额置换。该事项由联合保荐机构海通证券和中金公司于2020年9月29日出具了相关核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年度，公司募投项目未发生变更，不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，联合保荐机构认为，中芯国际2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，中芯国际不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。截至2023年12月31日，中芯国际募集资金已经按照募集资金用途全部投入募投项目使用完毕，并已完成全部募集资金专户的销户手续。联合保荐机构对中芯国际2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为海通证券股份有限公司关于《中芯国际集成电路制造有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：


郑瑜


陈城

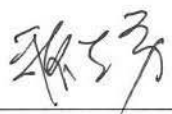


海通证券股份有限公司

2024年3月28日

（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《中芯国际集成电路制造有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



魏先勇



李扬



附件 1:

募集资金使用情况对照表 2023 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		5,251,560.72				本年度投入募集资金总额			-			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			5,251,560.72			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		-										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
							③=②-①	④=②/①				
12 英寸芯片 SN1 项目	否	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
先进及成熟工艺研发项目储备资金	否	700,000.00	700,000.00	700,000.00	-	700,000.00	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
成熟工艺生产线建设	否	979,696.62	979,696.62	979,696.62	-	979,696.62	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	1,771,864.10	1,771,864.10	1,771,864.10	-	1,771,864.10	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	5,251,560.72	5,251,560.72	5,251,560.72	-	5,251,560.72	-	100%	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				不适用。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023 年度，不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023 年度，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2023 年度，不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2023 年度，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	2023 年度，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	详见本核查意见三（八）募集资金使用的其他情况。

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

中芯国际集成电路制造有限公司

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

2023 年度



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安永华明（2024）专字第70017693_B01号
中芯国际集成电路制造有限公司

中芯国际集成电路制造有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的中芯国际集成电路制造有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，中芯国际集成电路制造有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2023年度中芯国际集成电路制造有限公司募集资金存放与实际使用情况。

本报告仅供中芯国际集成电路制造有限公司披露2023年度报告使用，不适用于其他用途。

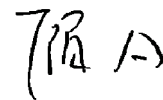
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2024）专字第70017693_B01号
中芯国际集成电路制造有限公司

（本页无正文）



中国注册会计师：孟冬



中国注册会计师：顾凡

中国 北京

2024年3月28日


中芯国际集成电路制造有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1278号）的批准，中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票193,846.30万股（含超额配售选择权），发行价格人民币27.46元/股，本次发行最终募集资金总额为人民币5,323,019.40万元，扣除保荐承销费后实际收到募集资金金额为人民币5,253,820.15万元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月14日及8月17日分别出具了普华永道中天验字[2020]第0590号《验资报告》及普华永道中天验字[2020]第0739号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

项目	金额（人民币万元）
实际收到的募集资金金额	5,253,820.15
减：支付发行费用	2,259.43
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	449,445.27
减：募投项目支出金额	4,843,167.20
减：募集资金账户销户利息转出	21.20
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	41,072.95
截至2023年12月31日募集资金专户余额	-

截止2023年12月31日，公司募集资金已经按照募集资金用途全部投入募投项目使用完毕，并于2023年12月31日前完成全部募集资金专户的销户手续。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。

中芯国际集成电路制造有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

二、募集资金管理情况（续）

（二）募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户。2020年7月7日及2020年8月21日，公司与联合保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》及《募集资金（针对超额配售）专户存储四方监管协议》。2021年4月7日及2021年4月26日，公司与海通证券、中金公司分别同中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。针对不同的募集资金投资项目，公司与项目公司实施主体、海通证券、中金公司分别同中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中信银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截止2023年12月31日，公司已完成全部募集资金专户的销户手续，上述募集资金监管协议相应终止。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金专户的余额列示如下：

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额 (人民币万元)	备注
招商银行上海分行营业部	NRA110925662010101	活期存款	-	已销户
招商银行上海分行营业部	NRA110925662032501	活期存款	-	已销户
中国银行上海市浦东开发区支行	444280470222	活期存款	-	已销户
中国银行上海市浦东开发区支行	437780471584	活期存款	-	已销户
民生银行上海金桥支行	630984295	活期存款	-	已销户
中国农业银行上海张江高科技园区支行	03348700040035789	活期存款	-	已销户
中信银行广州珠江新城支行	8110901011901196131	活期存款	-	已销户
浦发银行上海虹桥支行	98860078801300001507	活期存款	-	已销户
FT 农行上海金桥支行国际部	FTN09778100048500217	活期存款	-	已销户
中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行	FTN000009907	活期存款	-	已销户

中芯国际集成电路制造有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年度，公司不存在用闲置募集资金投资现金管理类产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金及超额配售募集资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2020年8月6日，公司董事会审议通过了《关于公司首次公开发行股票超额募集资金用途的议案》，同意公司利用超募资金中的人民币1,000,000.00万元、人民币500,000.00万元、人民币300,000.00万元分别用于12英寸芯片SN1项目、成熟工艺生产线建设项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

2020年8月6日，公司召开董事会会议，审议通过《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后续相关事项的议案》。根据该议案，董事会授权董事长、联合首席执行官及联席公司秘书中任何一位人士代表公司审议同意超额配售选择权实施情况，并授权董事长、联合首席执行官及联席公司秘书中任何一位人士代表公司签署与此相关的法律文件，以及提交任何必要的文件，并采取所有适用法律、规则及规例要求或据此进行的任何与此相关的行动（包括于香港联交所、上海证券交易所及本公司网站刊发公告）。2020年8月14日，联席公司秘书代表公司审议通过《关于公司首次公开发行股票超额配售选择权实施情况的议案》。根据该议案，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票超额配售选择权于2020年8月14日全额行使，发行总股数扩大至193,846.30万股。全额行使超额配售权所发行股票对应的募集资金总额为694,306.88万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币685,280.89万元，分别用于成熟工艺生产线建设项目人民币479,696.62万元及补充流动资金人民币205,584.27万元。

（七）节余募集资金使用情况

2023年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

中芯国际集成电路制造有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

三、本年度募集资金的实际使用情况（续）

（八）募集资金使用的其他情况

根据公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在募投项目实施期间，通过银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式，以自有资金支付募集资金投资项目中所涉及的部分设备采购及原材料支出，并定期以募集资金等额置换。该事项由联合保荐机构海通证券和中金公司于2020年9月29日出具了相关核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年度，公司募投项目未发生变更，不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。



中芯国际集成电路制造有限公司董事会

2024年3月28日

中芯国际集成电路制造有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

附表 1:

募集资金使用情况对照表
2023 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		5,251,560.72		本年度投入募集资金总额								
变更用途的募集资金总额												
变更用途的募集资金总额比例(%)								已累计投入募集资金总额		5,251,560.72		
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 ①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 ②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 ③=②-①	截至期末投入进度 (%) ④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
12 英寸芯片 SN1 项目	否	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-	100	不适用	不适用	不适用	否
先进及成熟工艺研发项目储备资金	否	700,000.00	700,000.00	700,000.00	-	700,000.00	-	100	不适用	不适用	不适用	否
成熟工艺生产线建设	否	979,696.62	979,696.62	979,696.62	-	979,696.62	-	100	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	1,771,864.10	1,771,864.10	1,771,864.10	-	1,771,864.10	-	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	5,251,560.72	5,251,560.72	5,251,560.72	-	5,251,560.72	-	100	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品的情况。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。							
募集资金结余的金额及形成原因					本年度不存在募集资金结余的情况。							
募集资金其他使用情况					详见本报告三 (八) 募集资金使用的其他情况。							

注 1: “截至期末承诺投入金额” 以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

中芯国际集成电路制造有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

2023 年度



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2024）专字第70017693_B02号
中芯国际集成电路制造有限公司

中芯国际集成电路制造有限公司董事会：

我们审计了中芯国际集成电路制造有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024）审字第70017693_B01号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，中芯国际集成电路制造有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中芯国际集成电路制造有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中芯国际集成电路制造有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对中芯国际集成电路制造有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解中芯国际集成电路制造有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中芯国际集成电路制造有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。

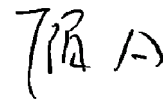
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2024）专字第70017693_B02号
中芯国际集成电路制造有限公司

（本页无正文）



中国注册会计师：孟冬



中国注册会计师：顾凡

中国 北京

2024年3月28日

附表

中芯国际集成电路制造有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



单位：人民币千元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	中芯国际集成电路制造(北京)有限公司	子公司	其他应收款	62,787,819	6,345,507	-	-	69,133,326	资金往来	非经营性往来
	中芯南方集成电路制造有限公司	子公司	其他应收款	1,731,236	-	-	(687,948)	1,043,288	资金往来	非经营性往来
	中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司	子公司	其他应收款	5,251,904	-	-	(2,418,187)	2,833,717	资金往来	非经营性往来
	中芯国际集成电路制造(上海)有限公司	子公司	其他应收款	2,206,389	235,964	-	-	2,442,353	资金往来	非经营性往来
	中芯国际集成电路制造(天津)有限公司	子公司	其他应收款	209,413	183,480	-	-	392,893	资金往来	非经营性往来
	SMIC Tianjin (Cayman) Corporation	子公司	其他应收款	26,126	355	-	-	26,481	资金往来	非经营性往来
	SMIC, Americas	子公司	其他应收款	19,528	331	-	-	19,859	资金往来	非经营性往来
	芯电半导体(上海)有限公司	子公司	其他应收款	17,185	495	-	-	17,680	资金往来	非经营性往来
	SMIC Japan Corporation	子公司	其他应收款	9,416	-	-	(430)	8,986	资金往来	非经营性往来
	SMIC Europe S.r.l.	子公司	其他应收款	4,937	282	-	-	5,219	资金往来	非经营性往来
	萨摩亚商柏途企业有限公司台湾分公司	子公司	其他应收款	2,785	47	-	-	2,832	资金往来	非经营性往来
	上海市民办中芯学校	子公司	其他应收款	2,212	37	-	-	2,249	资金往来	非经营性往来
SilTech Semiconductor Corporation	子公司	其他应收款	254	35	-	-	289	资金往来	非经营性往来	
SilTech Semiconductor (Hong Kong) Corporation Limited	子公司	其他应收款	45	1	-	-	46	资金往来	非经营性往来	
总计				72,269,249	6,766,534	-	(3,106,565)	75,929,218		

本汇总表由以下人士签署：

法定代表人：刘训峰

主管会计工作负责人：吴俊峰

会计机构负责人：刘晨健